

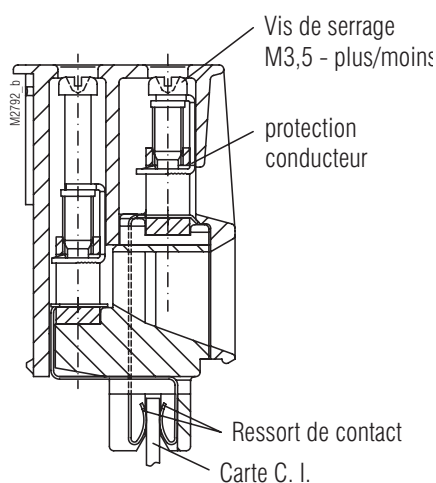
Boîtier en matière isolante KO 4733

avec bornes à deux étages
pour technique d'enfichage



KO 4733
carte sans
dispositif d'extraction

- Largeur utile 90 mm
- Max. 56 bornes équipées de vis cruciformes imperdables
- Bornes sur 2 étages avec fixations sur un même plan
- Blocs de bornes amovibles pour connexion à une carte de C.I.
- Blocs de 3, 4 ou 7 bornes ou bloc factice
- Possibilité de montage d'éléments SMD sur la face extérieure (côté soudure)
- utilisable en atmosphère explosive EExi conformément à EN 50 020
- Livré prêt à assembler



Bornes enfichables sur 2 étages

Homologation et sigles



Caractéristiques techniques

Références de commande:	beige	gris clair RAL 7035	bleu RAL 5015	translu- cide	noir
capot + 1 coulisseau PC	KO 4733-	1.6			1.1
capot + 1 coulisseau PA (UL)	KO 4733-				1.4
capot + 1 coulisseau PBT (UL)	KO 4733-	1.5			
châssis pôles PC (UL)	KO 4733-	2-1.1	2-1.3	2-1.4	2-1.7
carte sans dispositif d'extraction PC (UL)	ET 4720-	59-2.21	59-2.23	59-2.24	59-2.25
carte avec dispositif d'extraction PC (UL)	KO 4733-	13-1.1	13-1.3	13-1.4	13-1.5
bloc de 3 bornes PC	KO 4733-	3.21	3.23	3.24	
bloc de 3 bornes PA (UL)	KO 4733-				3.126
bloc de 3 bornes PBT (UL)	KO 4733-		3.158		
bloc de 4 bornes PC	KO 4733-	3.11	3.13	3.14	
bloc de 4 bornes PC PA (UL)	KO 4733-				3.124
bloc de 4 bornes PC PBT (UL)	KO 4733-		3.157		
bloc de 7 bornes PC PC	KO 4733-	3.1	3.3	3.4	
bloc de 7 bornes PA (UL)	KO 4733-				3.123
bloc de 7 bornes PBT (UL)	KO 4733-		3.156		
bloc factice PC	KO 4733-	3.31	3.33	3.34	

Dimensions extérieures: 90 x 84 x 118 mm

Matériau du boîtier: polycarbonate GF, capot gris clair
plastron: voir tableau

Résistance à la température:	PC	PA	PBT
selon UL 746 B:	125 °C	120 °C	120 °C
selon Vicat		212 °C	
ISO 306 méth. B:	148 °C	212 °C	134 °C
selon ISO 75-2 méth. A:	138 °C	230 °C	145 °C
méth. B:	144 °C	210 °C	150 °C

Puissance dissipée adm. max.: 25 W pour boîtiers isolés
en climat normal 23/50-1 ISO 554

Résistance thermique spécifique: $R_{th} = 4 \text{ K} / \text{W}$ pour boîtiers isolés

Inflammabilité:
selon UL 94: PC: V-0; carte translucide = V-2; PA: V-0; PBT: V-0

Nombre de bornes: max. 56, < 56 sur demande

Matériau des bornes: alliage cuivre étamé

Sections max. des conducteurs: 1 x 2,5 mm² multibrins avec embout DIN 46 228-1/-2/-3/-4
1 x 4 mm² massif ou 2 x 1,5 mm² multibrins avec embout

Longueur à dénuder: 10 mm

Résistance intérieure de contact
max. vers la carte de C.I.: 15 mΩ

Courant max. admissible des blocs de bornes doubles:	(UL) ex. 1	ex. 2	ex. 3	(UL) ex. 4	ex. 5	(UL) ex. 6
∞ Σ I _{max.} = 15 A	5 5					
∞ Σ I _{max.} = 28 A	7 7 7 7	8 6 7 7	8 6 8 6			
∞ Σ I _{max.} = 35 A	5 5 5 5	5 5 5 5 8 4 4 4	3 2 2 8 6 7 7	2 3 2 7 7 7 7	1 1 5 8 6 8 6	5 5 5 3 7 7 3

□ = valeur max. par connexion, □ = valeur max. par rangée de bornes

Connectique: vis cruciformes imperdables M 3,5; bornes avec bride
solidaire protégée contre la rupture de conducteurs

Couple de réglage: 0,8 Nm max.

Connexions internes: enfichage direct de la carte de C.I.

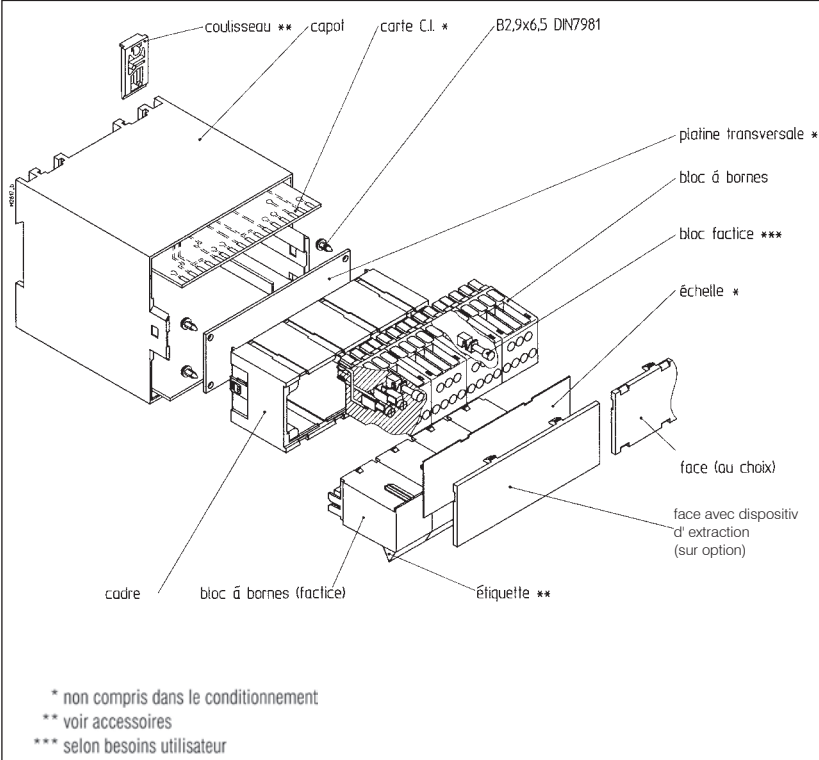
Fixation du boîtier:	par encliquetage sur rail EN 50 022 ou par vis M4 selon entr'axe de 86 mm		
Tenue aux courants de fuite:	PC: CTI 175 ≙ matériau isolant III a	IEC 60 664-1	
	PA: CTI 600 ≙ Isolierstoff I	IEC 60 664-1	
	PBT: CTI 225 ≙ Isolierstoff III	IEC 60 664-1	
Distances dans l'air et lignes de fuite:	≥ 3,3 mm selon IEC 61 010-1 avec carte de C.I. enfichée		
Degré de protection:	boîtier IP 40	IEC 60 529	
	bornes IP 20	IEC 60 529	
	protection contre les contacts directs selon VBG 4		
Surface de marquage:	sur le plastron 90 x 33 mm		
Taille des cartes de C.I.:	① = 63 cm ² , ③ = 54 cm ² , ④ = 27 cm ² , ⑥ = 55 cm ²		
Maintien des cartes C.I.:	par 2 glissières sur la face étroite et par vis sur le plastron		
Poids net:	300 g		

Accessoires:

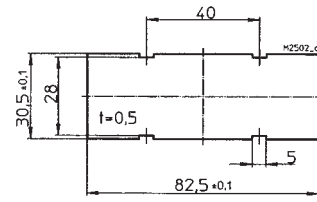
		gris RAL 7035	bleu RAL 5015	noir
carte signalétique	KO 4730-	3-1.3	3-1.4	3-1.5

2 coulisseaux
pour fixation par vis ET 4086-0-2

Schéma éclaté

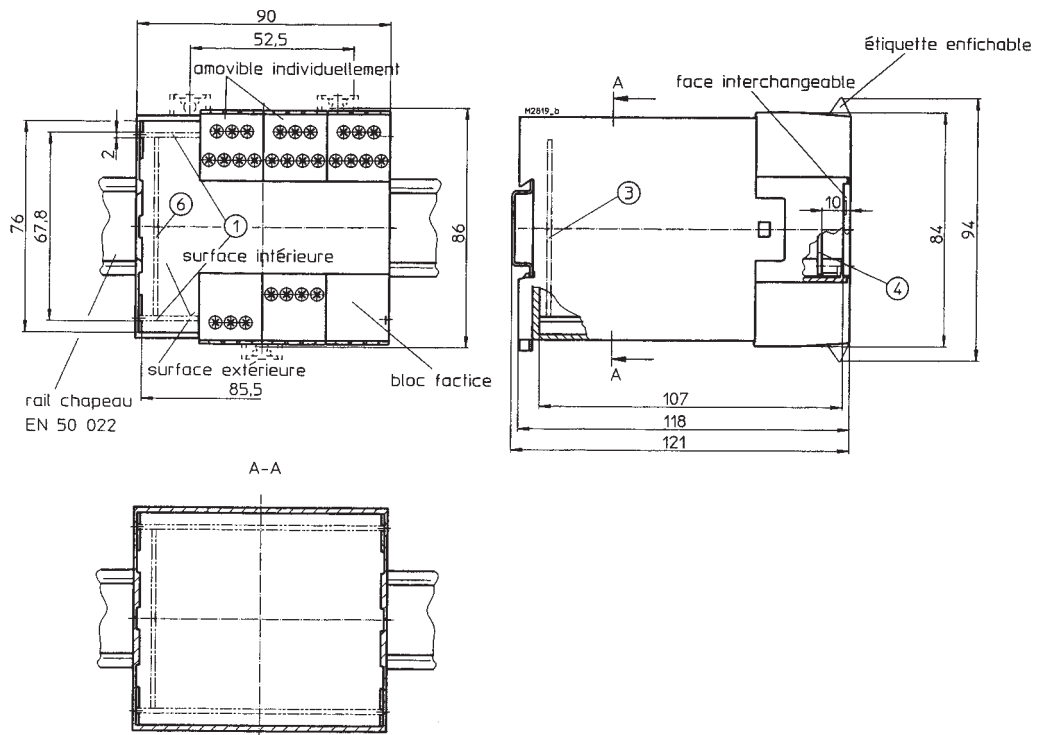


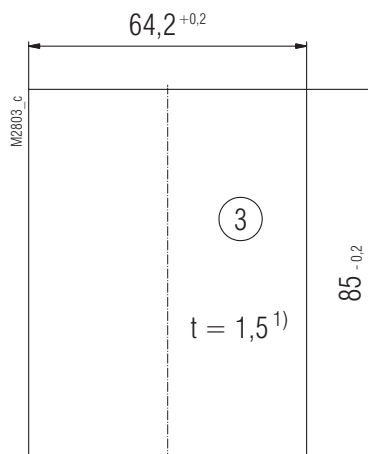
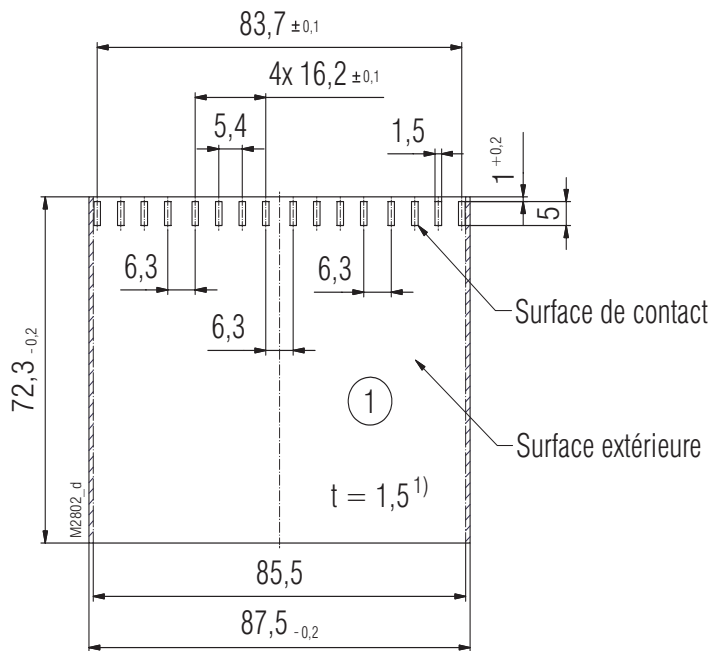
Echelle



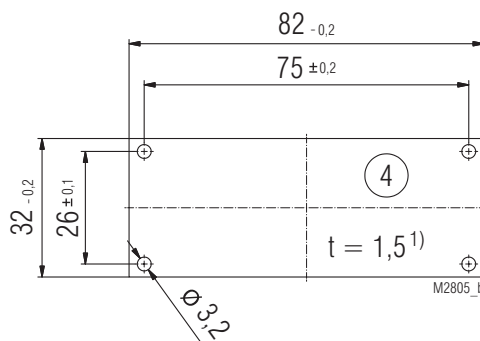
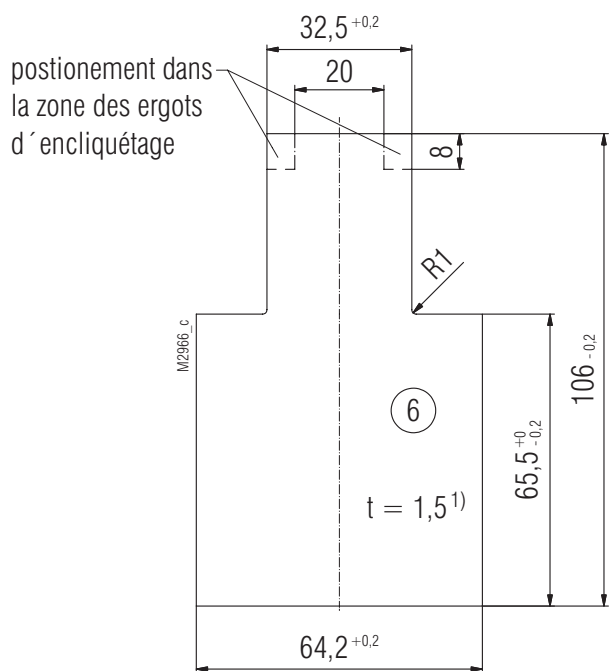
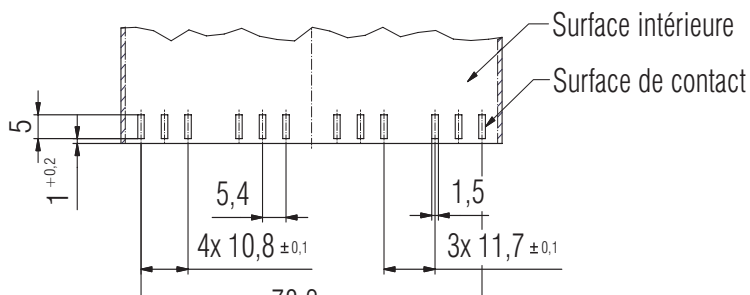
t = épaisseur circuit imprimé

Dimensions





Recommandation pour la soudure des surfaces de contact.
Etain pur Sn100, 10.....30µm épaisseur



 Zone interdite

¹⁾ Tolérance selon DIN EN 60249-2-4

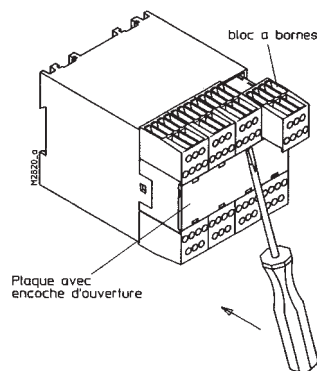
Tolérance générale : PERFAG 2 E

1. Outil

- Pour toutes les fonctions, utiliser un tournevis de 0,8 x 4,0 ou 0,8 x 4,5

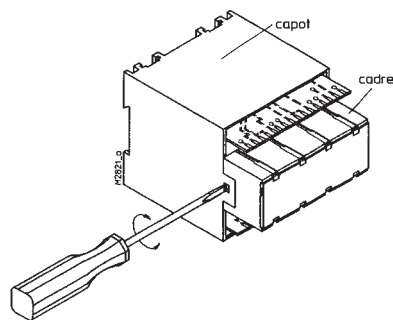
2. Démontage des blocs de bornes

- Introduire le tournevis dans le système d'extraction de la plaque
- Déverrouiller les blocs de bornes en inclinant le tournevis dans le sens de la flèche plaque avec dispositif
- Retirer les blocs
- Nota : le retrait des blocs de bornes est impossible sans le système d'extraction.



3. Démontage du châssis

- Les blocs de bornes doivent avoir été retirés.
- Introduire le tournevis dans les évidements latéraux du capot (bord inférieur).
- Effectuer une rotation à droite ou à gauche en maintenant une légère pression.
- Le taquet d'encliquetage du châssis se dégage.
- Répéter cette opération du côté opposé.
- On peut retirer le châssis.



4. Démontage de la plaque

- Introduire le tournevis dans l'évidement latéral de la plaque.
- Le tourner vers la droite ou vers la gauche.
- La plaque se dégage et peut être retirée.

